

# 電解手動金めっきライン

品目(最表層外観)	めっき厚 $\mu\text{m}$	加工寸法(mm)				純度(%)	めっきラインの特徴
		厚さ		サイズ			
		最小	最大	最小	最大		
硬質厚付け金 (光沢)	Au 0.3~5 / Ni 2~10	0.1	6	100*100	510*610	金99.95	ドライフィルム対応の部分めっき可能 金・コバルト合金めっき(Hv180) 端子めっき(マスクング)
硬質厚付け金 (無光沢)	Au 0.3~5						非磁性・ニッケルス
軟質金 (無光沢)	Au 0.1~3 / Ni 1~7						金ワイヤボンディング用 無光沢・光沢ニッケルの選択可能 ニッケルス
軟質金 (無光沢)	Au 0.3~3				400*500	銀99.99	金ワイヤボンディング可能 下地にニッケルめっき追加可能
軟質銀 (無光沢)	Ag 0.5~8						
錫 (無光沢)	Sn 1~8				510*610	錫99.9	鉛フリー対応 下地にニッケルめっき追加可能

複合めっき	端子めっき	無電解金めっき Au0.05 + マスキング + 電解金めっき付け足し Au0.5~3
	表裏めっき仕様違い	表 Au0.1 + マスキング + 裏面 Au0.5~3 表 軟質金 + マスキング + 裏面 硬質金



電解手動めっきライン



検査室



蛍光X線膜厚計



ボンディング用基板(電解ソフト金めっき)